

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年6月19日(19.06.2025)



(10) 国際公開番号

WO 2025/126563 A1

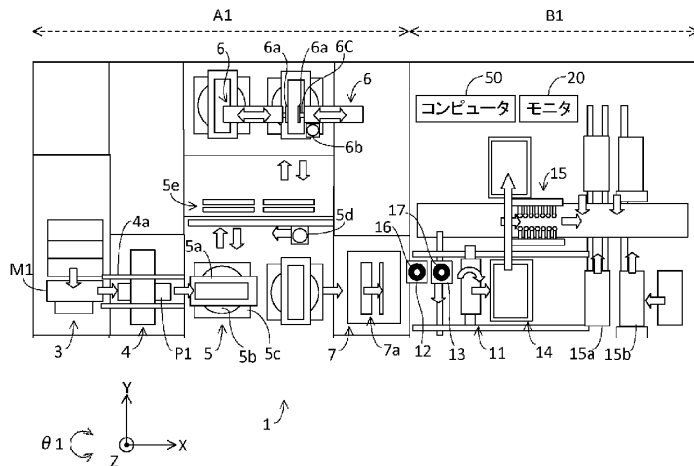
(51) 国際特許分類:
G01N 21/956 (2006.01) H01L 21/66 (2006.01)
(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/028193
(22) 国際出願日: 2024年8月7日(07.08.2024)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願 2023-210826 2023年12月14日(14.12.2023) JP
(71) 出願人: T O W A 株 式 会 社 (TOWA CORPORATION) [JP/JP]; 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地 (JP).

(72) 発明者: 宮 田 和 志 (MIYATA, Kazushi); 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地 T O W A 株式会社内 (JP). 伊澤佳乃(IZAWA, Yoshino); 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地 T O W A 株式会社内 (JP). 尾関 貴俊(OZEKI, Takatoshi); 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地 T O W A 株式会社内 (JP). 中村 一美(NAKAMURA, Kazumi); 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地 T O W A 株式会社内 (JP). 木村 朱里(KIMURA, Akari); 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地 T O W A 株式会社内 (JP).

(54) Title: INSPECTION SYSTEM, SEMICONDUCTOR MANUFACTURING DEVICE, AND INSPECTION METHOD

(54) 発明の名称: 検査システム、半導体製造装置及び検査方法

[図1]



20 Monitor
50 Computer

(57) Abstract: This inspection system comprises a table, a camera, a first movement mechanism, a second movement mechanism, and a control unit. The control unit controls each of the camera, the first movement mechanism, and the second movement mechanism such that a plurality of items of first partial image data each representing mutually different parts of an electronic component are generated. The control unit executes: first processing for subjecting each of the plurality of items of first partial image data to correction taking into account the inclination of the camera with respect to a first

[続葉有]

(74) 代理人: 藤原 賢 司, 外 (FUJIWARA, Satoshi et al.); 〒5300047 大阪府大阪市北区西天満 5 - 1 - 1 5 西天満パークビル 2 号館 4 階 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

axis, and correction taking into account the difference between an angle formed by the first axis and a second axis and a reference angle; second processing for generating composite image data by combining the plurality of corrected items of first partial image data; and third processing for inspecting the electronic component on the basis of the composite image data.

(57) 要約: 検査システムは、テーブルと、カメラと、第1移動機構と、第2移動機構と、制御部とを備える。制御部は、各々が電子部品の互いに異なる部分を示す複数の第1部分画像データが生成されるようにカメラ、第1移動機構及び第2移動機構の各々を制御する。制御部は、第1軸に対するカメラの傾きを考慮した補正、並びに、第1軸及び第2軸によって形成される角度と基準角度との差分を考慮した補正を複数の第1部分画像データの各々に施す第1処理、補正後の複数の第1部分画像データを合成することによって合成画像データを生成する第2処理、及び、合成画像データに基づいて電子部品を検査する第3処理を実行する。